



平成 24 年 11 月 12 日

各 位

上場会社名 T O W A 株式会社  
代 表 者 代表取締役社長 岡田 博和  
コード番号 6315 (東証・大証 1 部)  
問合せ先責任者 執行役員管理本部長 岸本 昌利  
TEL (075) 692 - 0251

## 超大判化対応への要素技術および製品開発について

スマートフォン等のモバイル機器に搭載される半導体デバイスは、更なる高性能化、高密度化、低消費電力化が求められており、今後は T S V (シリコン貫通電極) などの先端技術によって 3 次元に積層されたデバイスが主流になるものと予想されます。これらの半導体デバイスには高い実装技術に加え、コストダウンの要求も非常に強く、ウェーハレベル組立や従来の組立用基板の大型化があわせて進むものと考えられます。

ウェーハレベル組立では、従来サイズの 8 インチや 12 インチから数年先には 18 インチへと拡大し、組立用基板では 1 0 0 mm × 3 0 0 mm のサイズから □ 3 0 0 mm へと移行、最終的には □ 5 ~ 6 0 0 mm までを計画する半導体メーカーもあります。このような領域では、モールドイング工程における従来のプレス機構や金型および成形材料の考え方では対応できないことが予想されます。

当社は、当社の独自技術である顆粒樹脂を用いた樹脂流動の無い成型プロセスをベースに、これらの大面積ワークのパッケージングに対しても信頼性の高いモールドイングプロセスを提供するため、その要素技術の開発および製品化へ、さらに経営資源を投入してまいります。

### 記

#### 1、開発内容 (主な項目)

- ・超大判化対応金型、プレス機構の試作および評価実施
- ・各種モールド用樹脂材料の成形評価
- ・金型要素技術、成形プロセスの確立

#### 2、開発スケジュールと投資予定

##### (1) 開発スケジュール

- |                  |                   |
|------------------|-------------------|
| ①要素技術確立および樹脂材料評価 | 2013 年 3 月末を目処に完了 |
| ②評価機の製作          | 2014 年 3 月期中に実施   |
| ③製品化・付加要素の構築     | 2014 年 3 月以降順次対応  |

##### (2) 投資総額

2014 年 3 月期末までに 3.5 億円を計画。  
以降は製品化・付加要素に応じて投資内容を決定。

以上